

导热填隙垫片

性能

- 柔软贴合
- 高导热及浸润性
- 适用不同高度及累加公差的脆性元件
- 玻纤加固，易于操作、抗撕裂

主要应用

- 半导体和散热器之间
- CD/DVD冷却
- 热管组件
- 内存模块
- DDR SDRAM
- 硬盘冷却
- 电源
- IGBT模块
- 信号放大器



夹具/螺丝

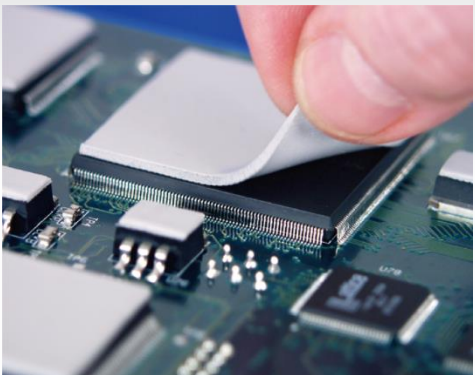


间隙>0.5mm



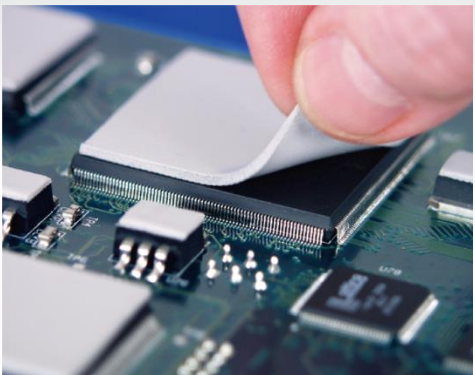
固态





导热填隙垫片





导热填隙垫片



产品	描述	导热系数 (W/m-k)	硬度 (Shore 00)	厚度 (mm.)	击穿电压 (Vac.)	阻燃等级 (UL 94)
BERGQUIST GAP PAD TGP 5000	高导热性、“S级”柔软和服帖性 硅胶垫片	5.0	35	0.508- 3.175	> 5,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP HC 5000	玻璃纤维增强, 硅胶垫片	5.0	35	0.508- 3.175	> 5,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 3004SF	单面永久离型膜结构, 无硅配方, 聚合物垫片	3.0	70	0.254-3.175	> 5,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 2700	导热、未增强型间隙填充材料	2.7	80	0.508- 3.175	> 6,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP A2600	导热、增强型间隙填充材料	2.6	80	0.381-3.175	> 5,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 2000SF	无硅配方, 导热间隙填充材料	2.0	70	0.254-3.175	> 5,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 2200SF	玻璃纤维增强, 无硅配方聚合物垫片	2.0	70	0.010- 0.125	> 5,000	V-0



产品	描述	导热系数 (W/m-k)	硬度 (Shore 00)	厚度 (mm)	击穿电压 (Vac.)	阻燃等级 (UL 94)
BERGQUIST GAP PAD TGP 2202SF	无硅配方, 高性能导热, 玻璃纤维聚合物垫片	2.0	70	0.254- 3.175	-	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP A2000	高性能导热填隙材料	2.0	80	0.254-1.016	4,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 1500	无基材, 硅胶垫片	1.5	40	0.508-5.080	> 6,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 1500R	玻璃纤维增强, 硅胶垫片	1.5	45	0.254-0.508	> 6,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 1000HD	高耐用导热填隙材料	1.0	40	0.508-3.175	>10,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 1100SF	玻璃纤维增强, 无硅配方, 聚合物垫片	0.9	40	0.254-3.175	> 6,000	V-1
BERGQUIST GAP PAD TGP 800VO	用于填充气隙的 保形导热材料	0.8	40	0.508-6.350	> 6,000	V-0



产品	描述	导热系数 (W/m-k)	硬度 (Shore 00)	厚度 (mm)	击穿电压 (Vac.)	阻燃等级 (UL 94)
BERGQUIST GAP PAD TGP 3000	增强型“S级”极柔软导热垫片	3.0	30	0.254-3.175	> 3,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 3000ULM	极柔软导热垫片, 低应力下导热性能优越	3.0	20	1.0-4.0	> 6,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP HC 3000	玻璃纤维增强, 硅胶垫片	3.0	15	0.508-3.175	> 5,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 2400	高服帖性, 导热, 增强型“S级”间隙填充材料	2.4	20	0.254-6.35	>3,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 2000	高服帖性, 导热, 增强型“S级”间隙填充材料	2.0	40	0.508-3.175	>5,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 1300	高服帖性, 导热, 增强型“S级”间隙填充材料	1.3	30	0.508-6.35	> 6,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 1350	单面永久离型膜结构, 硅胶垫片	1.3	30	0.508-3.175	> 6,000	V-0



产品	描述	导热系数 (W/m-k)	硬度 (Shore 00)	厚度 (mm.)	击穿电压 (Vac.)	阻燃等级 (UL 94)
BERGQUIST GAP PAD TGP 1000VOUS	玻璃纤维增强, 硅胶垫片	1.0	5 (Shore 00)	0.508-6.350	6,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP EMI1000	导热型柔性电磁干扰吸收材料	1.0	5 (Shore 00)	0.508-3.175	> 1,700	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP HC 1000	“凝胶状” 模量缝隙填充材料	1.0	25 (Shore 00)	0.254-0.508	> 5,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 800VOS	高顺从, 用于填充空气间隙的导热材料	0.8	25 (Shore 00)	0.508-5.080	> 6,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 12000ULM	高导热、超低模量导热垫片	12.0	68 (Shore 000)	1.0-3.18	6,200	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 10000ULM	高顺从, 低压缩应力, 超低模量导热垫片	10.0	75 (Shore 000)	1.0-3.18	3,200	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 7000ULM	超柔软导热垫片, 在低压下具有出色的热性能	7.0	75 (Shore 000)	0.5-3.18	> 5,000	V-0



产品	描述	导热系数 (W/m-k)	硬度 (Shore 000)	厚度 (mm.)	击穿电压 (Vac.)	阻燃等级 (UL 94)
BERGQUIST GAP PAD TGP 6000ULM	极软、超低模量、硅胶间隙填充材料	6.0	60	1.524-3.175	> 5,000	V-0
BERGQUIST GAP PAD TGP 3500ULM	超低模量, 玻璃纤维增强, 硅胶垫片	3.5	70	0.508-3.175	> 5,000	V-0

